

Orbotech Diamond™ 10T/10TXL

ソルダーマスク向けダイレクトイメージング装置

Orbotech Diamond™ 10T/10TXL

Orbotech Diamond 10T/10TXLは、厚いソルダーマスク向けに開発された最先端のダイレクトイメージング装置です。

製造現場で実証されている露光技術により、厳しいアンダーカット要件に対処しつつ高スループットおよび高品質な露光を提供いたします。

Orbotech Diamond 10T/10TXLは、KLA独自のSolderFast™ (ソルダファスト) テクノロジーを搭載し、厚いソルダーマスク製品においてもトータルコスト (TCO) を削減し高精度・高品質露光を可能にします。



特長

高品質・高スループット露光

- 特許取得済みの高出力光源を搭載
- 3波長光源により、高品質な断面形状、最小アンダーカットでの露光が可能
- 1/パスで高スループットと均一で高品質な露光が可能
- オン・ザ・フライターゲット認識技術による高速アライメントが可能
- 深い焦点深度により、うねりのある基板への高品質露光が可能
- 特別に設計された光源が、厚いソルダーマスク露光でのアンダーカット要件に対応

高生産性

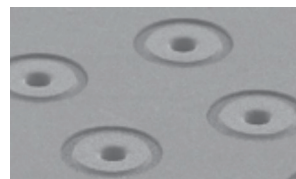
- 素早く簡単な露光セットアップが可能
- 2段テーブル搬送メカニズムにより装置稼働時間を最大限に活用
- メカニカルクランプによる基板固定
- Industry 4.0 やオートメーションにも接続可能

高精度なレジストレーション

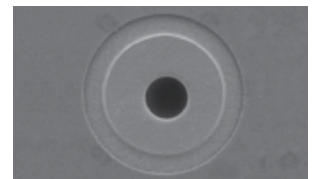
- 位置合わせ精度 $\pm 10\mu\text{m}$ の高精度なレジストレーション
- 革新的なスケーリングモードを搭載し、歪んだパネルにも高精度にて露光が可能

トータルコストの大幅削減

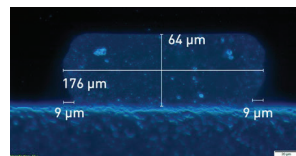
- 高い生産効率
- 長寿命LEDを使用することにより、オペレーションコストを削減
- 製造にかかる電力コストの削減



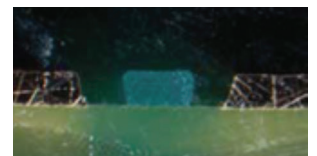
高品質なソルダーマスク露光
ビア内に残留物なし



高精度位置合わせ精度



60µm以上の厚いソルダーマスク



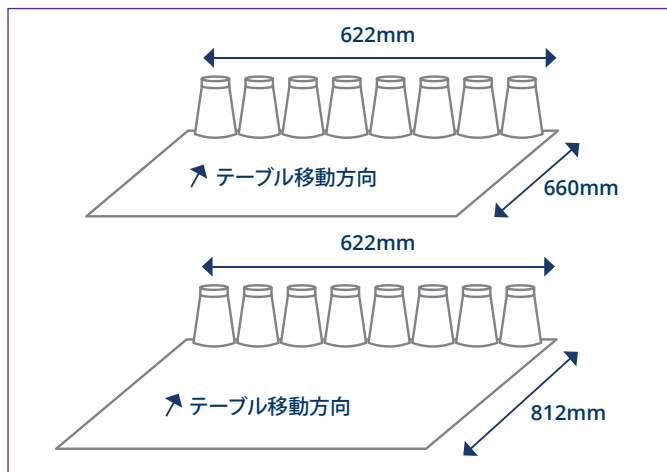
100µmソルダーダム、40µm厚ソルダーマスク

テクノロジー



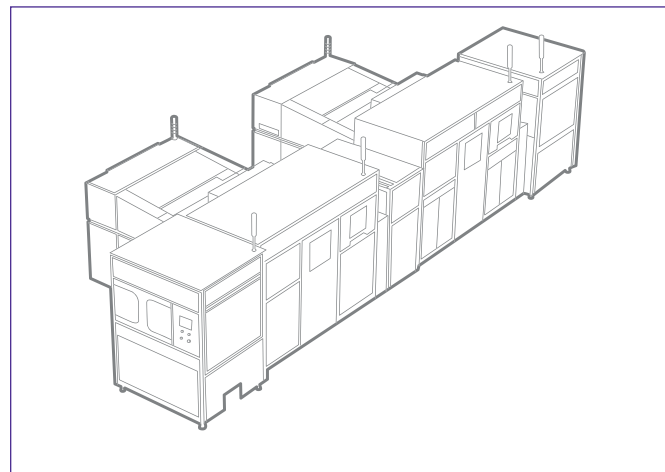
SolderFast™ Technology

高品質、高スループット露光

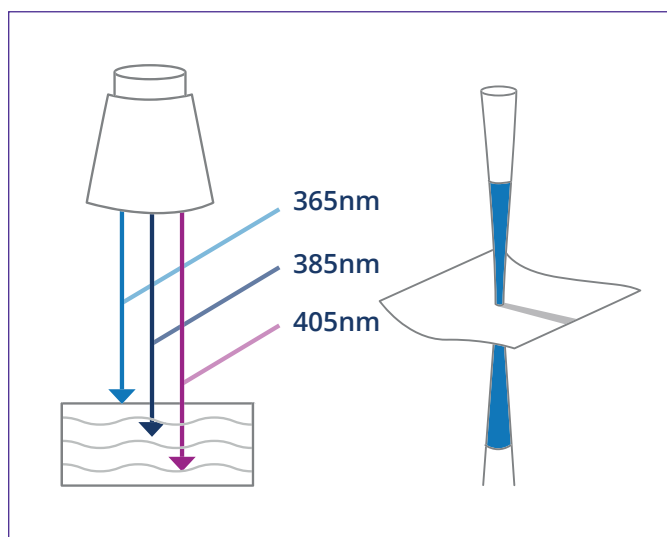


高スループット、高い面内均一性・高品質な1パス露光

量産工程での高い生産性

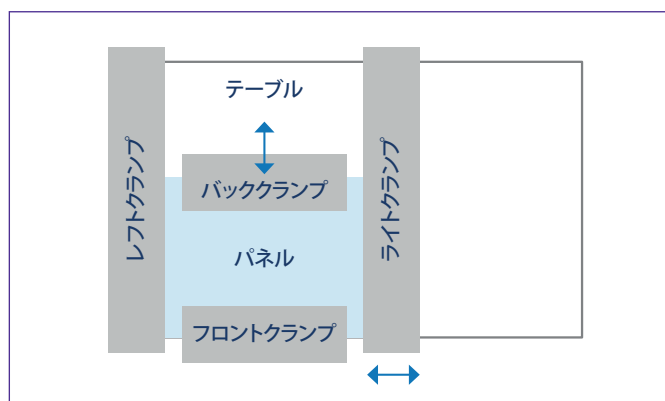


オートメーション接続可能



広範囲の3波長露光により、高品質な表面及び側面仕上がりを提供

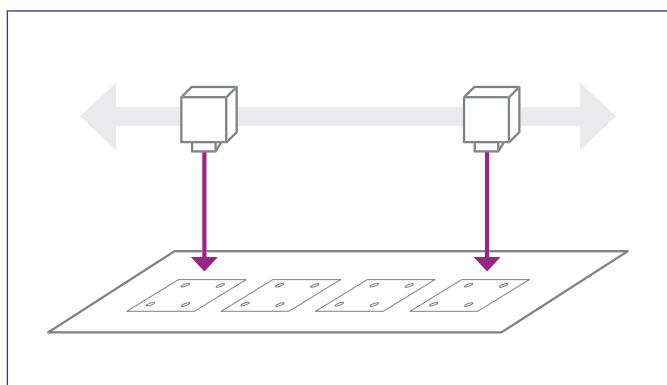
深い焦点深度により、うねりのある基板への高品質露光



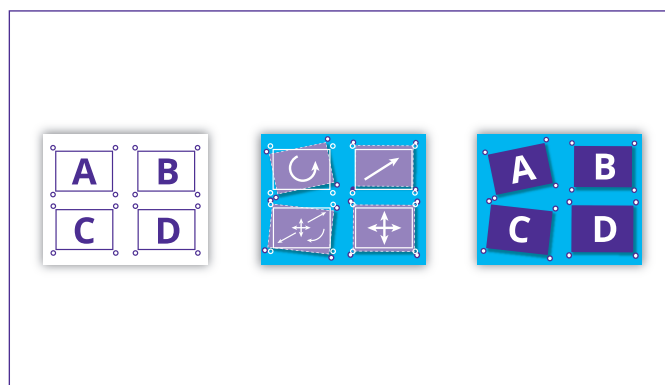
メカニカルクランプによる基板固定

高精度なレジストレーション

革新的なスケーリングモードにより歪んだパネル露光にも対応
オートスケーリング、パーシャルスケーリング、ノンリニアスケーリングをサポート



オン・ザ・フライターゲット認識技術による高速アライメント



CAMデータ

基板

露光

仕様

	Orbotech Diamond 10T	Orbotech Diamond 10TXL
最小SRO *	75μm	
最小ダムサイズ *	50μm	
位置合わせ精度 **	±10μm	
最大パネルサイズ (X/Y)	635mm × 660mm (25" × 26")	635mm × 812mm (25" × 32")
最大パネルサイズ (クランプ付き) (X/Y)	622mm × 584mm (24.5" × 23")	622mm × 762mm (24.5" × 30")
最大露光サイズ (X/Y)	622mm × 660mm (24.5" × 26")	622mm × 812mm (24.5" × 32")
最大露光サイズ (クランプ付き) (X/Y)	609mm × 571mm (24" × 22.5")	609mm × 749mm (24" × 29.5")
設定露光エネルギー範囲	50-2,200mj/cm ²	
寸法	高さ: 1,960mm 奥行: 3,226mm 幅: 1,900mm	高さ: 1,960mm 奥行: 3,315mm 幅: 1,900mm
重量	5,000Kg	
クランプ	オプション	
アプリケーション	ソルダーマスク露光	

* ソルダーレジストのタイプによる

** すべて3σで測定

仕様は予告なく変更されることがあります。

KLA SUPPORT

高い歩留まりを実現するKLAのソリューションにとって、装置の生産性維持は非常に重要です。この実現のため、当社ではメンテナンス、グローバルでのサプライチェーン管理、コスト削減、製品ライフサイクル管理、装置移設、性能・生産性の向上、認証ツールの再販売などに注力しています。

© 2022 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。「オルボテック」は、KLAカンパニーであるOrbotech Limitedの登録商標です。「KLA」とKLAのロゴは、KLA Corporationの登録商標です。記載されたブランド名および製品名は全て各社の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation
TEL: 045-522-7725
Email: Japan-ICS-PCB@kla.com
www.kla.com

Rev 4.0_5-19-2022 (J)